

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(43) 国际公布日:
2003年7月10日(10.07.2003)

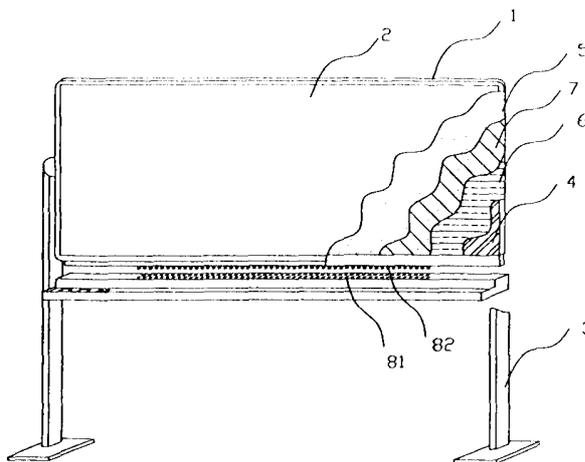
PCT

(10) 国际公布号:
WO 03/056418 A1

- (51) 国际分类号⁷: G06F 3/033 中国北京市西城区西直门南大街16号, Beijing 100035 (CN)。
- (21) 国际申请号: PCT/CN02/00689
- (22) 国际申请日: 2002年9月27日(27.09.2002)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
01279677.8 2001年12月29日(29.12.2001) CN
02130933.7 2002年9月17日(17.09.2002) CN
- (71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 台均实业有限公司(TAI GUEN ENTERPRISE CO., LTD) [CN/CN]; 中国台湾省桃园县中坜市环北路400号10F之7, Taiwan (CN)。
- (72) 发明人;及
- (75) 发明人/申请人(仅对美国): 施宜明(SHI, Xuanming) [CN/CN]; 中国台湾省桃园县中坜市环北路400号10F之7, Taiwan (CN)。
- (74) 代理人: 北京北新智诚专利代理有限公司 (BEIJING BEIXIN-ZHICHENG PATENT AGENT CO., LTD);
- (81) 指定国(国家): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) 指定国(地区): ARIPO专利(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI专利(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- 本国际公布:
— 包括国际检索报告。
- 所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: AN ELECTROMAGNETIC INDUCTION ELECTRONIC BOARD WITH ANTENNA ARRAYED IN GRIDDING INSIDE

(54) 发明名称: 内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板



(57) Abstract: An electromagnetic induction electronic board with antenna arrayed in gridding inside, which included: a writing input part and frame surrounding with the writing input part and a control circuit device. The writing input part had a multilayer instruction, comprising surface writing layer and inputting sense layer and bottom layer. The output of sense layer was connect with the control circuit and the sense layer was set on insulation layer with antenna arrayed in gridding along X and Y axis direction. Each of the space made by gridding formed a sense unit.

[见续页]



WO 03/056418 A1



(57) 摘要

一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层、输入感应层和底层，感应层的输出接控制电路，感应层为设置在绝缘隔膜上的沿 X、Y 轴方向的天线阵列，每个阵列网格所围设的空间构成一个感应单元。

内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板

技术领域

本发明涉及一种电子白板，尤其是一种成本低、制造简便并且识别精度高的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，属于电子技术领域。

背景技术

在工作和生活中，人们常常需要使用白板完成记录或讨论事项。例如在教学和会议中，白板虽然能够较好地书写上文字、符号等，也能够方便地擦除，但是其做记载的内容是一次性地出现，而无法再现和存储。因此，日益难以满足当前数字化生活和工作的应用需求。

随着电子技术的发展，无论是在学校的授课环境，还是部门的研讨过程中，开始使用了电子白板。这种产品能够及时地将书写在白板上的符号，转换为电信号，输入给所连接的计算机，通过计算机再直接完成编辑或打印、传输等远程信息交换。现有的电子白板由于感应面积较大，或者不能制作，例如印刷线路板的腐蚀制作电磁感应式；或者由于成本太高，而不能采用触摸屏等电阻式的感应结构，因此电子白板多采用输入笔与电子白板之间的超声波发射、接收方式进行操控，其成本依然较高，而且精度较低，大大限制了这类产品的应用。导致这个信息交流和产生的环节迟迟不能够被广泛地数字化。

综上所述，现有产品都存在着明显地识别率低，精度差，而且成本较高，制造困难等，以至于不能够被广泛应用的缺点。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术之不足而提供一种内置隔膜天线阵列网

格电磁感应层的电子白板，它成本较低、生产制造简便，而且数据采集识别的精度高。

本发明的又一目的在于提供一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，使用寿命长，维护简单。

本发明的目的是通过如下的技术方案实现的：

一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，它包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层、输入感应层和底层，输入感应层设有书写层和底层之间，感应层的输出接控制电路，感应层为设置在绝缘隔膜上的沿 X、Y 轴方向的天线阵列，每个阵列网格所围设的空间构成一个感应单元。

感应层的面积与书写层和底层同样大小或小于书写层和底层，即感应层完全附设或者部分附设在书写层和底层之间。感应层附设位置在书写输入部分书写范围的一侧或中央。

为了增强设备的抗干扰的能力，在感应层后还设有屏蔽层。同时，感应层与底层之间还设有缓冲层，或感应层与屏蔽层之间还设有缓冲层。

感应层还可以为印制在绝缘隔膜上、分别沿 X、Y 轴方向的天线阵列，其每个网格所围设的空间构成一个感应单元。为了降低成本，绝缘隔膜为菲林材质。感应层可以是覆在绝缘隔膜上的铜铂蚀刻后形成的天线阵列，可以是软性印刷线路（FPC）天线阵列，还可以是印制在绝缘隔膜上为银浆或银浆碳浆混合材质的天线阵列。

感应层可印制在绝缘隔膜两面上，或印制在绝缘隔膜一面上，两层绝缘隔膜叠放构成。

为了提高电子白板的精度，将一层以上的感应层叠设在一起，且各感应

层上的感应单元为交错布置。每层感应单元的间隔大小相同或不同。

为了增大电子白板的书写面积，感应层的面积也要相应增大，可以将蚀刻或印制有天线阵列的一块以上隔膜相互拼接构成，各块上分别设有 X、Y 方向天线阵列引出电气连接装置，各块之间通过导线引出电气连接装置连接。

连接装置为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点 (PIN-PIN) 连接装置或焊点 (VGA) 热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

其控制电路包括信号放大滤波采集、数据处理，还设有信号输出控制电路和/或存储装置。信号输出装置包括具有计算机标准数据接口的电缆或无线数据交换装置射频发射/接收器。

信号输出装置接计算机和/或打印机或外部数据存储设备或通过调制解调辅助装置接电话线。

控制电路与感应层两者为一体直接连接，控制电路的器件直接设置在天线阵列输出端上，控制电路设置本体内。

控制电路连设在软性印刷线路 (FPC) 天线阵列的输出端，其上直接设置控制电路的器件。

控制电路的器件设置在与感应层分体设置的印刷线路板上，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片与印刷线路板中间，在硬质压片与天线阵列输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与天线阵列输出端螺合压接在印刷线路板上，天线阵列输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接。

控制电路与本体一体设置，可设置在本体的周边外框。

控制电路设置在本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层的天线

阵列输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。

感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片与电气连接装置中间，在硬质压片与天线阵列输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与天线阵列输出端螺合压接在电气连接装置上，天线阵列输出端与电气连接装置对应的输入引脚连接。

感应层输出接口和控制电路接口为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

电子白板的本体框架外设有支架，本体架设在支架上。控制电路设置在支架内，接口设置在支架上，感应层输出接口在本体的位置对应控制电路接口。

为了携带、挂放方便，电子白板的书写输入部分、围设在其周边的保护边框为柔性可卷曲材质。

在电子白板本体的一侧边固接在卷轴内，卷轴两端设有收合本体的扭簧，本体另一侧边端设有定位卡扣。控制电路可设置在卷轴内。

根据上述技术方案分析可知，本发明结构简单合理，制作工艺简单，大大降低了电子白板的成本，维护方便，而且较大地提高了感应精度，能够被广泛地普及，解决了该环节数字化的问题，更加丰富了当代数字化产品的形态，产生利用电子白板主渠道之一进行交流的应用模式。

附图说明

图 1 为本发明实施例一立体结构示意图；

图 2 为本发明感应层沿 Y 轴方向蚀刻或印制的天线阵列结构示意图；

图 3 为本发明感应层沿 X 轴方向蚀刻或印制的天线阵列结构示意图；

图 4 为本发明感应层 X、Y 轴方向天线阵列所构成的感应单元整体结构示意图；

图 5 为本发明感应信号产生、输入笔位置识别原理示意图；

图 6 为本发明感应层一块以上拼接的结构和电气连接接口示意图；

图 7 为本发明两层感应层叠放的结构示意图；

图 8 为本发明感应层与控制电路分体设置连接关系结构示意图；

图 9 为本发明天线阵列输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接关系结构示意图；

图 10 为本发明实施例二立体结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方案对本发明做进一步地详细说明。

实施例一：

如图 1 所示，本发明为一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框 1 部分和控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层 2、输入感应层 5 和底层 4，输入感应层 5 设有书写层 2 和底层 4 之间，感应层 5 的输出接控制电路。

如图 1 所示，为了增强设备抗干扰能力，感应层 5 后还设有屏蔽层 6，该屏蔽层 6 能够有效地克服感应层 5 电磁对控制电路工作的干扰。

感应层 5 与底层 4 之间还设有缓冲层 7，或感应层 5 与屏蔽层 6 之间还设有缓冲层 7。缓冲层 7 的功能在于保持感应层与书写平面以及屏蔽层 6 之间有合理的间隙。此外，笔的电磁信号发射无论在笔压下或未压下均有电磁信号发生，以方便控制。当然可以做成笔未压下无信号，此外笔还可以做到压力感

应，均在笔上实现通过频率不同体现。

如图 2、3、4 所示，感应层 5 还可以为印制在绝缘隔膜 55 上、分别沿 X、Y 轴方向的天线阵列 52、51，其每个网格所围设的空间构成一个感应单元 53。为了降低成本，绝缘隔膜 55 为菲林材质。感应层 5 可以是覆在绝缘隔膜 55 上的铜铂蚀刻后形成的天线阵列，可以是软性印刷线路（FPC）天线阵列，还可以是印制在绝缘隔膜上为银浆或银浆碳浆混合材质的天线阵列。

感应层可印制在绝缘隔膜两面上，或印制在绝缘隔膜一面上，两层绝缘隔膜叠放构成。

图 7 所示，为提高电子白板的精度，将一层以上的感应层 5 和 5' 叠设在一起，各感应层上的感应单元 53 交错布置。每层感应单元 53 的间隔大小可以相同或者不同。各层感应单元 53 的间隔大小不同，大小叠放后，必然坐标的间隔缩小，也就提高了感应的精度。感应单元 53 大小相同的感应层叠放在一起时，因为彼此的位置是交错布置的，坐标间隔也缩小了，从而提高了电子白板的灵敏度。

如图 6 所示，如果电子白板的书写面积较大，感应层的面积也要相应扩大，可以将一块以上带有隔膜的导线电磁感应层 5 和 5' 相互拼接构成，各块上分别设有 X、Y 方向导线引出电气连接装置 56 和 57，各块之间通过导线引出电气连接装置 56 和 57 连接。

上述的连接装置 56 和 57 可以为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

电子白板的信号输出装置为有线电缆连接装置或无线数据交换装置。有线电缆连接装置为具有 USB 接口的电缆；无线数据交换装置为射频发射/接

收器。这样可完成本地存储，或远程传输，或直接设置上网装置，将输入的内容打包为数据包，发送。当然，信号输出装置接计算机和/或打印机，直接将白板上感应采集的信息编辑、打印；再有，信号输出装置直接接数据存储设备，可将数据存储后，利用移动存储装置导入到计算机中，或其他设备中。信号输出装置与周边设备的具体电路结构与其他领域消费电子产品应用中的连接方式一致，在此不再赘述。

控制电路与感应层两者为一体直接连接，控制电路的器件直接设置在天线阵列输出端上，控制电路设置本体内。

控制电路连设在软性印刷线路（FPC）天线阵列的输出端，其上直接设置控制电路的器件。

控制电路的器件设置在与感应层分体设置的印刷线路板上，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

如图 9 所示，感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片 600 与印刷线路板 500 中间，在硬质压片 600 与天线阵列输出端之间设有缓冲层 7，硬质压片 600、缓冲层 7 与天线阵列输出端通过螺母 700 螺合压接在印刷线路板 500 上，天线阵列输出端与印刷线路板 500 对应的输入引脚 511' 连接。

控制电路与本体一体设置时，可以设置在本体周边的包覆框内。

如图 8 所示，控制电路 8 设置本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层 5 的天线阵列输出端以压接、插接或焊接方式与感应层输出接口 82 连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口 81。

感应层输出接口 82 和控制电路接口 81 可分别为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

控制电路与本体的分体设置，为电子白板的随时升级提供了方便，同时便于维护和保养。

如图 1 所示，本体框架 1 外设有支架 3，本体架 1 设在支架 3 上。控制电路 8 设置在支架 3 内，接口设置在支架 3 上，感应层输出接口 82 在本体的位置对应控制电路接口 81。

本发明的工作机理如图 5 所示：图中 P 是笔的信号输入端，笔头上有一较大的导体 P'，求得笔的平面坐标位置，从而确定笔的位置。

电磁笔不断地发射电磁信号，当笔尖触及感应发生装置时，其电磁信号穿过感应天线某位置，该位置的天线感应出信号，由感应发生装置将感应的位置信号通过 X、Y 方向的引线传递控制识别电路的输入口，经过阵列选通、控制方法、带通滤波、检波整流以及模数转换，给处理电路的 CPU 计算，判定电磁信号在感应天线的位置坐标和各种工作状态，通过通信接口发送给计算机，从而控制计算机识别、显示、记录等。

再有，为得到书写时笔尖的压力，提高信号位置感应的准确性，输入笔的笔尖后部设有 Z 轴方向压力传感器，该传感器的输出接电磁波发生装置的控制端。这样通过压触改变电磁波的发射信号，从而更为确切地识别笔尖的压力（输入信号）。

另外，信号输出装置为有线电缆连接装置或无线数据交换装置。有线电缆连接装置为具有 USB 接口的电缆；无线数据交换装置为射频发射/接收器。当然，信号输出装置接计算机和/或打印机，直接将白板上感应采集的信息编辑、打印；再有，信号输出装置直接接数据存储设备，可将数据存储后，利用移动存储装置导入到计算机中，或其他设备中。信号输出装置与周边设备的具体电路结构与其他领域消费电子产品应用中的连接方式一致，在此不再赘述。

本发明白板感应采集输出的数据为识别后数据，转换为笔移动轨迹的数据，或者为未识别数据，为笔的各时刻位置坐标数据。

实施例二：

如图 10 所示，本发明为一种内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，它本体包括书写输入部分、围设在其周边的保护边框以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在保护边框内，包括表面书写层 2 和底层 4，在书写层 2 和底层 4 之间设有输入感应层 5，感应层 5 的输出接控制电路，书写输入部分、围设在其周边的保护边框 1 为柔性可卷曲材质。

如图 10 所示，本体设置一侧边固接在卷轴 100 内，卷轴 100 两端设有收合本体的扭簧，本体另一侧边端设有定位卡扣 101。

如图 10 所示，为了携带以及收挂方便，电子白板的表面书写层 2、感应层 5、缓冲层 7、屏蔽层 6 以及底层 4 均为可卷弯的柔性材质。本体一侧边固接在卷轴 100 内，卷轴两端设有收合本体的扭簧，本体另一侧边端设有定位卡扣 101，用于电子白板收卷完全时的定位。其卷轴、扭簧以及相应机构与现有的投影幕布、卷帘窗帘等卷收机构相类似，在此不再赘述。可卷收的电子白板携带、收挂方便，节省空间。为外型美观、完整，控制电路可设置在卷轴 100 内。

本实施例的其他技术特征与实施例一均相同，详尽的实施方式可参见实施例一的相关内容，此处不再赘述。

以上实施例仅用以说明本发明而非限制，尽管参照以上较佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明进行修改、变形或者等同替换，而不脱离本发明的精神和范围，其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

权利要求书

1、 一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，它包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层、输入感应层和底层，输入感应层设有书写层和底层之间，感应层的输出接控制电路，其特征在于：所述的感应层为设置在绝缘隔膜上的沿 X、Y 轴方向的天线阵列，每个阵列网格所围设的空间构成一个感应单元。

2、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层的面积与书写层和底层同样大小或小于书写层和底层，即感应层完全附设或者部分附设在书写层和底层之间。

3、 根据权利要求 2 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的小于书写层和底层面积的感应层附设在书写输入部分书写范围的一侧或中央。

4、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层后还设有用于增强设备的抗干扰能力的屏蔽层。

5、 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层与底层之间还设有缓冲层，或感应层与屏蔽层之间还设有缓冲层。

6、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的绝缘隔膜为菲林材质。

7、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为覆在绝缘隔膜上的铜铂蚀刻后形成的天线阵列。

8、 根据权利要求 7 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为软性印刷线路（FPC）天线阵列。

9、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为印制在绝缘隔膜上为银浆或银浆碳浆混合材质的天线阵列。

10、 根据权利要求 9 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为印制在绝缘隔膜两面上，或印制在绝缘隔膜一面上，两层绝缘隔膜叠放构成。

11、 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 6 或 7 或 8 或 9 或 10 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为一层以上，各感应层上的感应单元彼此交错布置。

12、 根据权利要求 11 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的每层感应单元の間隔大小相同或不同。

13、 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 6 或 7 或 8 或 9 或 10 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为一块以上蚀刻或印制有天线阵列的隔膜相互拼接构成，各块上分别设有 X、Y 轴方向天线阵列引出电气连接装置，各块之间通过导线引出电气连接装置连接。

14、 根据权利要求 13 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的连接装置为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

15、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路包括信号放大滤波采集、数据处理，还设有

信号输出控制电路和/或存储装置。

16、根据权利要求 15 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的信号输出装置包括具有计算机标准数据接口的电缆或无线数据交换装置射频发射/接收器。

17、根据权利要求 16 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的信号输出装置接计算机和/或打印机或外部数据存储设备或通过调制解调辅助装置接电话线。

18、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 6 或 7 或 8 或 9 或 10 或 15 或 16 或 17 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路与感应层两者为一体直接连接，控制电路的器件直接设置在天线阵列输出端上，控制电路设置本体内。

19、根据权利要求 18 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路连设在软性印刷线路（FPC）天线阵列的输出端，其上直接设置控制电路的器件。

20、根据权利要求 1 或 6 或 7 或 8 或 9 或 10 或 15 或 16 或 17 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路的器件设置在与感应层分体设置的印刷线路板上，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

21、根据权利要求 20 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片与印刷线路板中间，在硬质压片与天线阵列输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与天线阵列输出端螺合压接在印刷线路板上，天线阵列输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接。

22、根据权利要求 21 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路与本体一体设置，可设置在本体的周边外框。

23、根据权利要求 20 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路设置在本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。

24、根据权利要求 23 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片与电气连接装置中间，在硬质压片与天线阵列输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与天线阵列输出端螺合压接在电气连接装置上，天线阵列输出端与电气连接装置对应的输入引脚连接。

25、根据权利要求 23 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层输出接口和控制电路接口为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

26、根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的本体框架外设有支架，本体架设在支架上。

27、根据权利要求 1 或 15 或 16 或 17 或 26 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路设置在支架内，接口设置在支架上，感应层输出接口在本体的位置对应控制电路接口。

28、根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，其特征在于：所述的书写输入部分、围设在其周边的包覆框为柔性可卷曲材质，电子白板本体可曲卷便携。

29、根据权利要求 28 所述的内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，其特征在于：所述的本体设置一侧边固接在卷轴内，卷轴两端设有收合本体的扭簧，本体另一侧边端设有定位卡扣。

30、根据权利要求 1 或 15 或 16 或 17 或 28 或 29 所述的内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，其特征在于：所述的控制电路可设置在卷轴内。

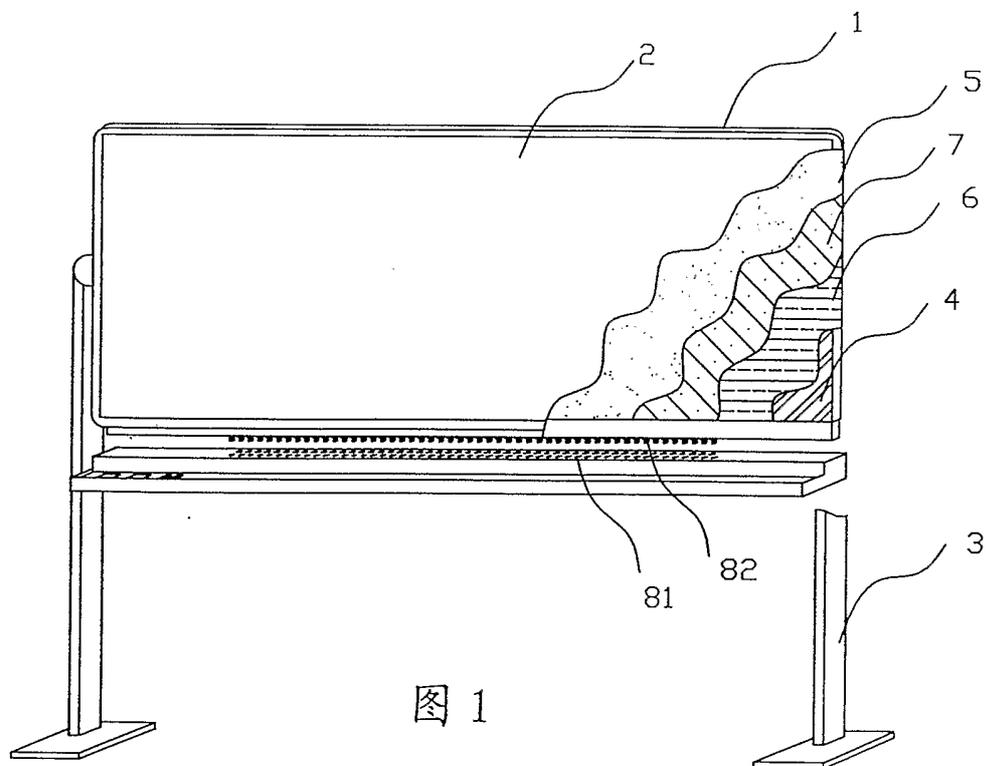


图 1

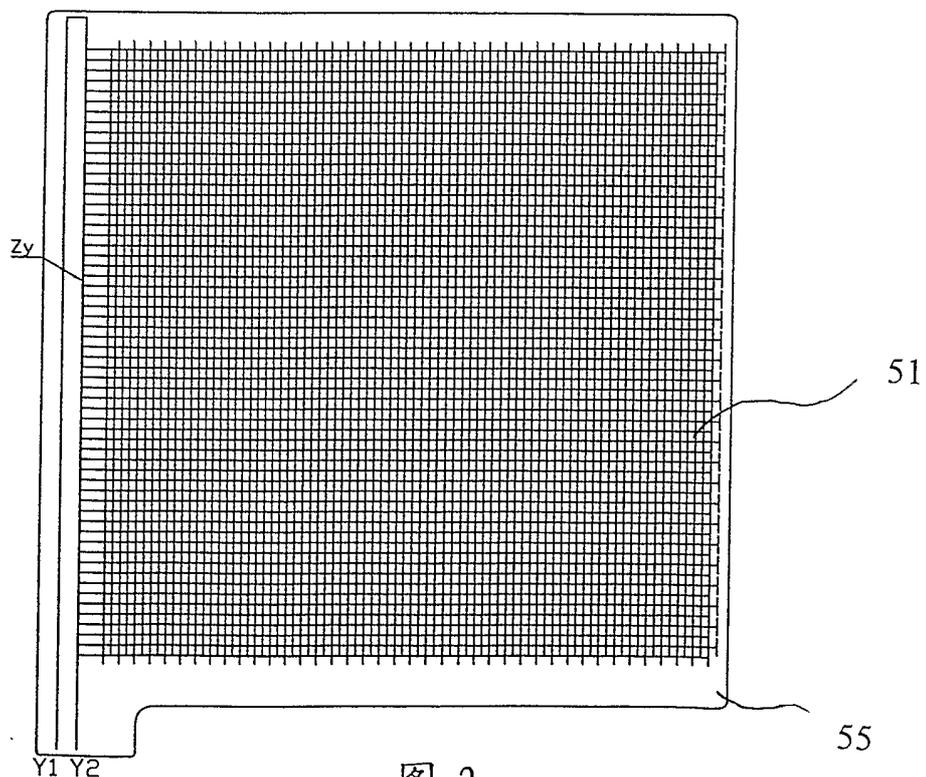


图 2

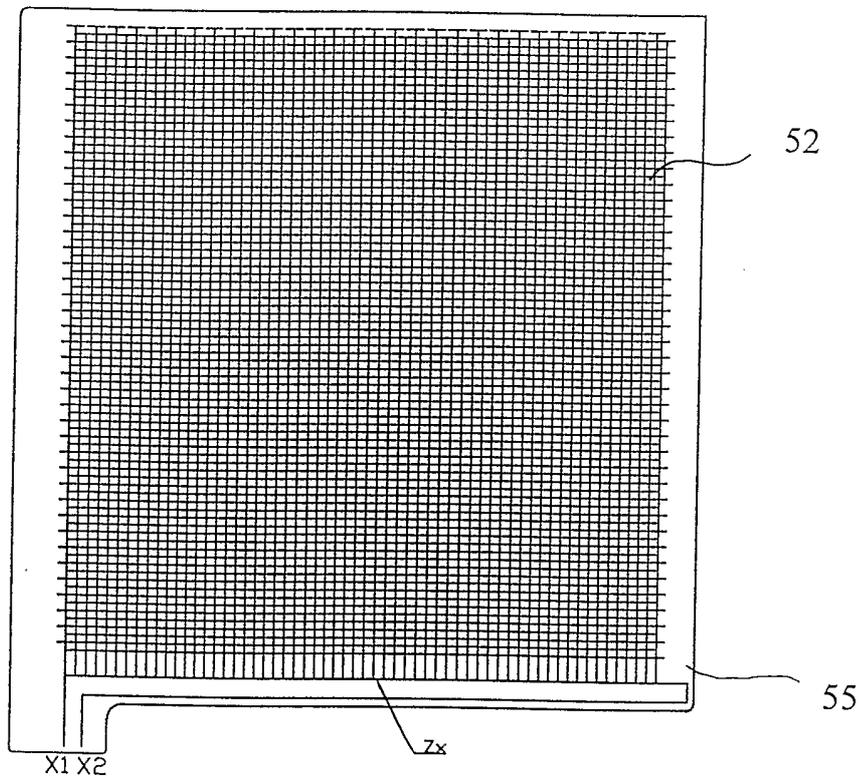


图 3

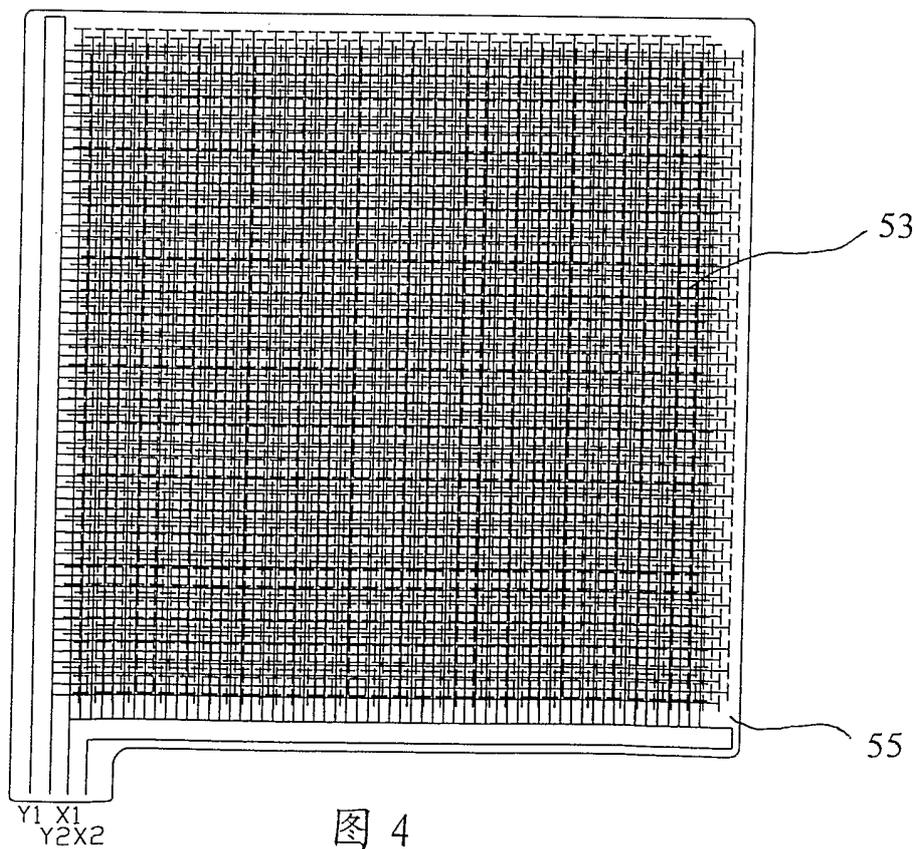


图 4

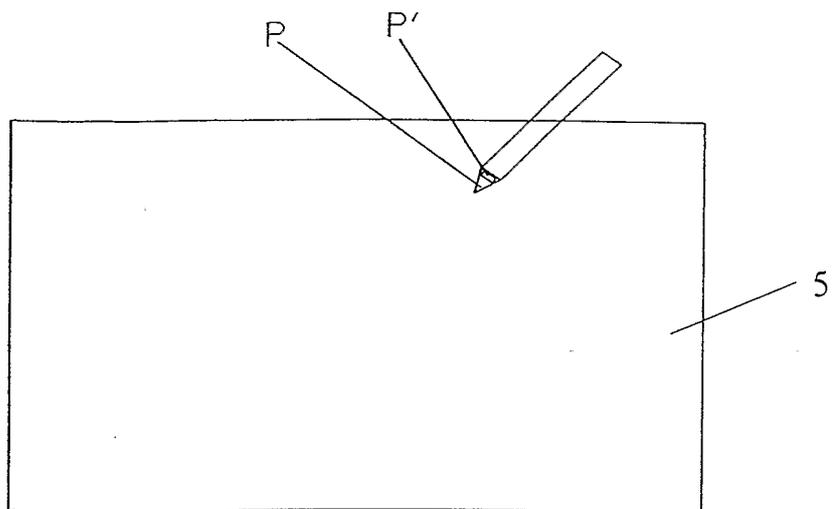


图 5

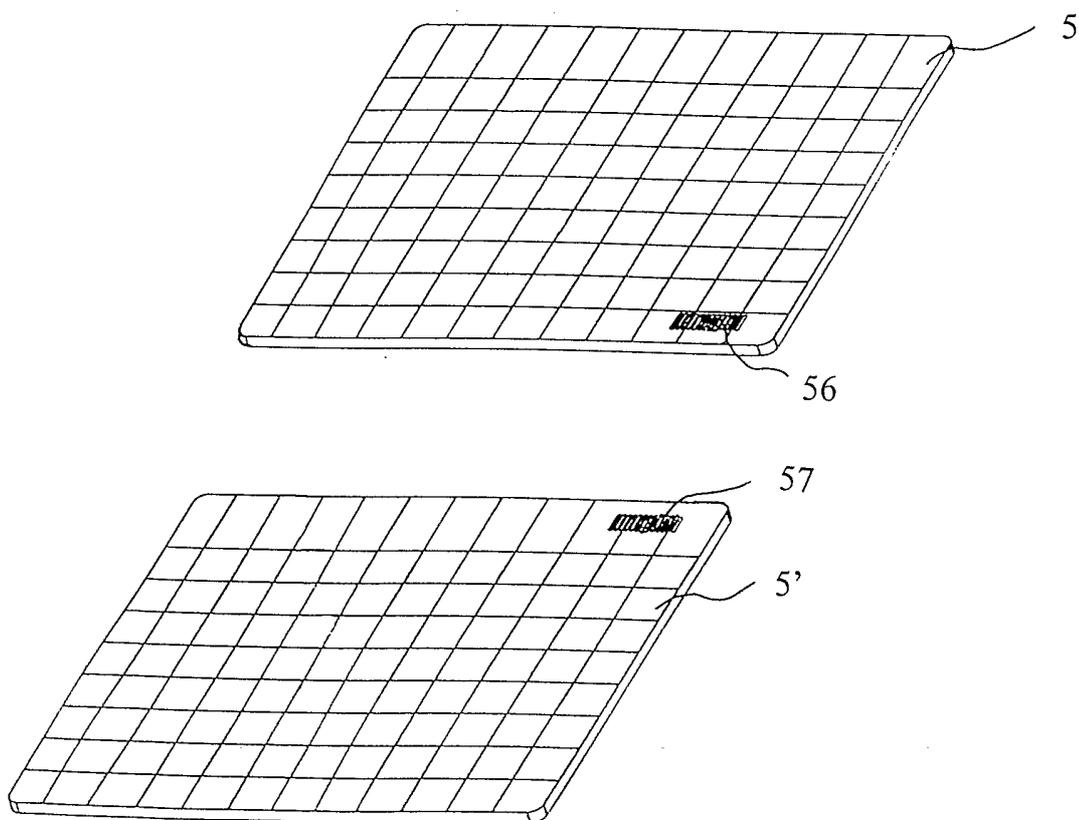


图 6

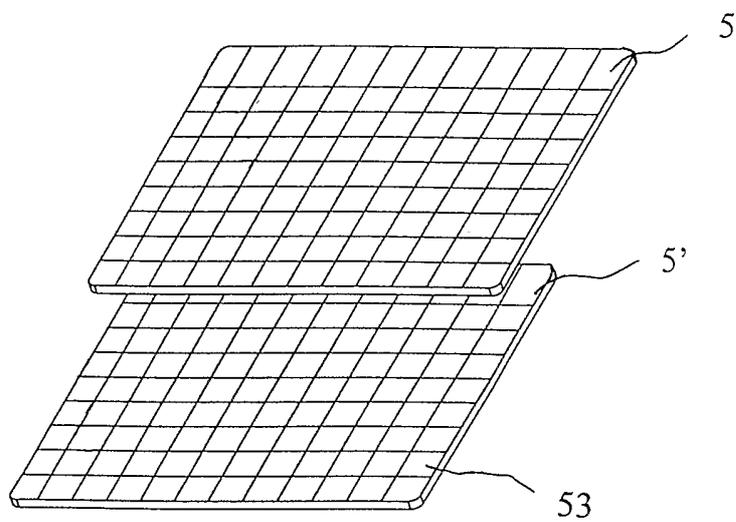


图 7

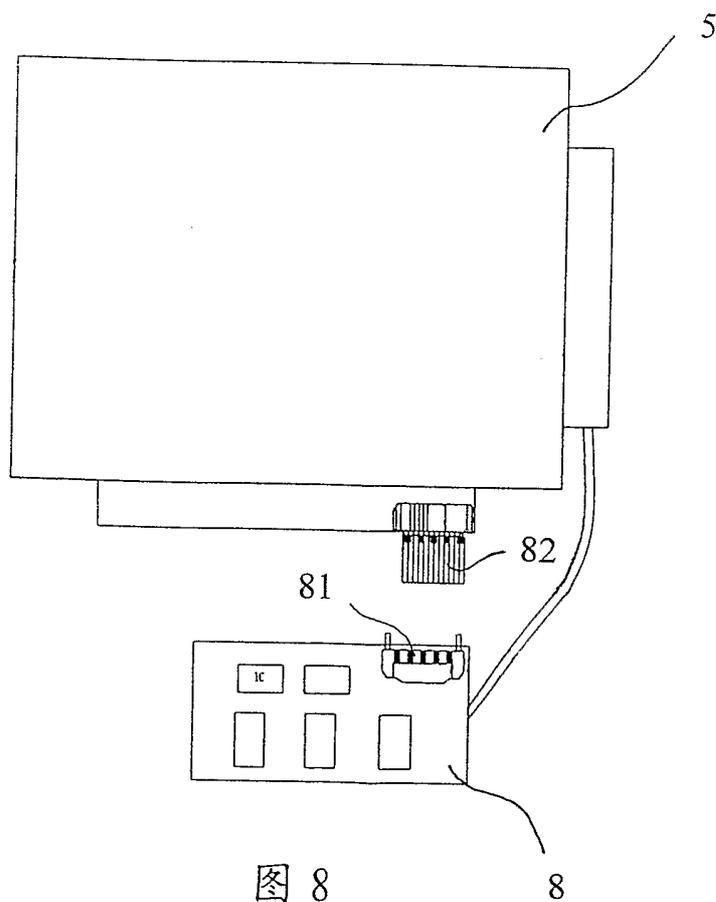


图 8

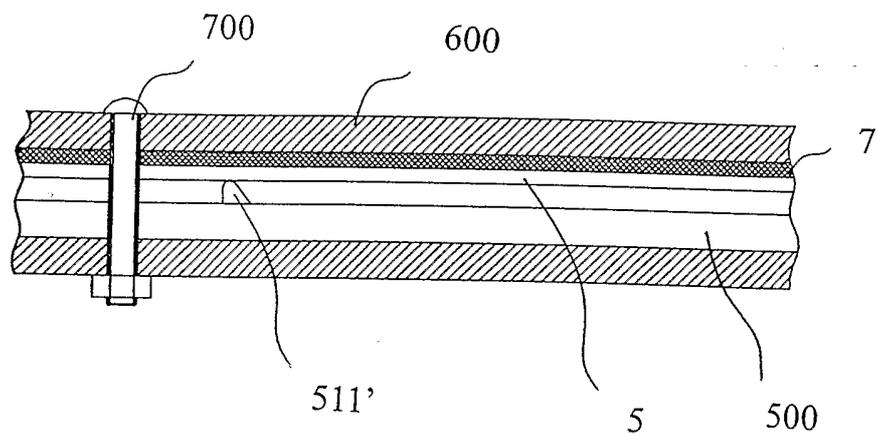


图 9

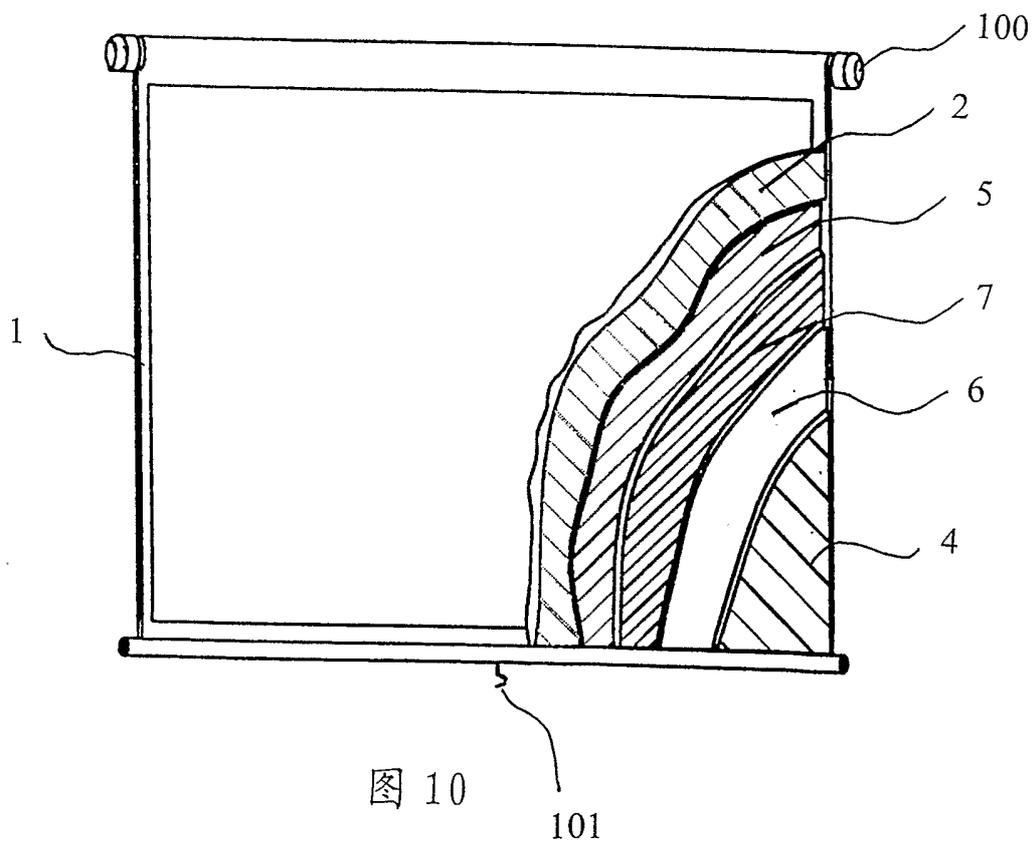


图 10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN02/00689

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <p style="text-align: center;">G06F3/033</p> <p style="text-align: center;">According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC</p>				
B. FIELDS SEARCHED <p style="text-align: center;">Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)</p> <p style="text-align: center;">G06F3/033 G06F3/00</p> <p style="text-align: center;">Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched</p> <p style="text-align: center;">Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)</p> <p style="text-align: center;">WPI,EPODOC,PAJ: electromagnetic w induction ,Insulation,gridding CNPAT:电磁感应, 绝缘, 网格</p>				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	JP2000172424A, 23,Jun 2000, HITACHI KOGANEI DENSHI KK; HITACHI SOFTWARE ENG ,the whole document	1-30		
A	JP2000172421A 23,Jun 2000 ,HITACHI KOGANEI DENSHI KK; HITACHI SOFTWARE ENG, the whole document	1-30		
A	JP11110135A 23,Apr 1999, TOTOKU ELECTRIC the whole document	1-30		
A	JP9305317A 28,Nov 1997 TOTOKU ELECTRIC the whole document	1-30		
A	GB2311362A 24,Dec 1997 OBERTSON NIGEL KEITH BOUCHIER (GB) the whole document	1-30		
A	JP2153419A 13,Jun 1990 SHARP KK the whole document	1-30		
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed </td> <td style="width: 50%; border: none;"> "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family </td> </tr> </table>			* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search <p style="text-align: center;">23.Dec 2002 (23.12.02)</p>	Date of mailing of the international search report <p style="text-align: center;">13 FEB 2003 (13.02.03)</p>			
Name and mailing address of the ISA/CN 6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District, 100088 Beijing, China Facsimile No. 86-10-62019451	Authorized officer <p style="text-align: center;">Liyunmei</p> Telephone No. 86-10-62093191			

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN02/00689

A. 主题的分类

G06F3 / 033

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类体系和分类号)

G06F3/033 G06F3/00

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和, 如果实际可行的, 使用的检索词)

WPI,EPODOC,PAJ: electromagnetic w induction ,Insulation,gridding CNPAT:电磁感应, 绝缘, 网格

C. 相关文件

类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求编号
A	JP2000172424A, 2000年6月23日, HITACHI KOGANEI DENSHI KK; HITACHI SOFTWARE ENG 全文	1-30
A	JP2000172421A, 2000年6月23日, HITACHI KOGANEI DENSHI KK; HITACHI SOFTWARE ENG 全文	1-30
A	JP11110135A, 1999年4月23日, TOTOKU ELECTRIC 全文	1-30
A	JP9305317A, 1997年11月28日 TOTOKU ELECTRIC 全文	1-30
A	GB2311362A, 1997年12月24日 OBERTSON NIGEL KEITH BOUCHIER (GB) 全文	1-30
A	JP2153419A, 1990年6月13日 SHARP KK 全文	1-30

其余文件在 C 栏的续页中列出。

见同族专利附件。

* 引用文件的专用类型:

“A” 明确叙述了被认为不是特别相关的一般现有技术文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先的申请或专利

“L” 可能引起对优先权要求的怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布的在后文件, 它与申请不相抵触, 但是引用它是为了理解构成发明基础的理论或原理

“X” 特别相关的文件, 仅仅考虑该文件, 权利要求所记载的发明就不能认为是新颖的或不能认为是有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 权利要求记载的发明不具有创造性

“&” 同族专利成员的文件

国际检索实际完成的日期
23.12 月 2002 (23.12.02)

国际检索报告邮寄日期
13. 2月 2003 (13. 02. 03)

国际检索单位名称和邮寄地址
ISA/CN
中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)
传真号: 86-10-62019451

授权官员

电话号码: 86-10-62093191